【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成19年10月11日(2007.10.11)

【公開番号】特開2006-114779(P2006-114779A)
【公開日】平成18年4月27日(2006.4.27)
【年通号数】公開・登録公報2006-017
【出願番号】特願2004-302037(P2004-302037)
【国際特許分類】
***Ｈ０５Ｋ　3/40　(2006.01)***
***Ｃ２３Ｆ　1/00　(2006.01)***
***Ｃ２３Ｆ　1/02　(2006.01)***
***Ｈ０５Ｋ　3/20　(2006.01)***
***Ｈ０５Ｋ　3/46　(2006.01)***
***Ｈ０５Ｋ　9/00　(2006.01)***
【ＦＩ】
Ｈ０５Ｋ　3/40　Ｄ
Ｈ０５Ｋ　3/40　Ｚ
Ｃ２３Ｆ　1/00　１０１
Ｃ２３Ｆ　1/00　１０３
Ｃ２３Ｆ　1/02
Ｈ０５Ｋ　3/20　Ａ
Ｈ０５Ｋ　3/46　Ｎ
Ｈ０５Ｋ　9/00　Ｖ

【手続補正書】
【提出日】平成19年8月23日(2007.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
前記のような保護フィルムを用いることにより、配線層膜間接続用部材を製造する従来技術の概要を図１０及び図１１に沿って以下に説明する。
図１０（１ａ）～（１ｆ）及び図１１（１ｇ）～（１ｌ）は、従来の配線層膜間接続用部材の製造工程、及びその配線層膜間接続用部材を使用して配線回路基板を製造する工程を順に示す模式的断面図である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
（７）工程（１ｋ）～（１ｌ）：
前記工程（１ｊ）で得られる回路形成用基板１４の導体回路形成用金属層２３，２４の各表面に、図１１（１ｋ）に示すように、エッチングマスクとなる導体回路用レジスト膜８を形成し、続いて、前記レジスト膜８をマスクとして導体回路形成用金属層２３，２４をエッチングすることにより、導体回路９を形成することができる。レジスト膜８を除去して、図１１（１ｌ）に示すように、配線回路基板１５が形成される。この配線回路基板

１５は、両方の表面に導体回路９を有し、両表面の各回路が必要な部分においてバンプ６を介して電気的に接続しており、しかも、各バンプ６が、絶縁性樹脂層７によって相互に電気的絶縁状態になる。